

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

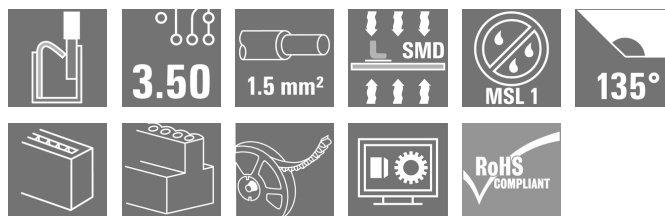
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



革新的で迅速な操作に対応するコネクタ – 簡易で、安全で、そして経済的：

バネ接続および直接のプッシュイン技術搭載 PCB 端子。接続技術における画期的製品。

驚くほど簡易で、実際にも驚異的な製品です：

- ツール不要で、フェルール端子を使用してソリッドワイヤまたは導体を接続し、簡単に接続解除ができます
- リフローまたは気相による自動処理
- 色分け押しボタンで明確に識別された電位およびクランプポイント

世界最高クラスの形状と処理フェーズで、幅広いアプリケーションに適しています。

リフローはんだ実装（SMD）による全自動組立に対応したプリント基板用端子で、PUSH INによる電線接続方式を採用しています。同方向からの電線挿入とスライダ操作（TOP）

- フェルールを取付けた撚り線や単線は、挿入するだけで接続可能です。
- フェルール無しの撚り線を接続する場合、クランプ部を開くためにレバーもしくはボタンを使用します。
- 電線挿入部と操作部が明確に分かれているため、直感的な操作が可能です。
- テープオンリール梱包（RL）
- 電線接続方向 135°

一般注文データ

バージョン	プリント基板端子台, 3.50 mm, 極数: 6, 135°, 黒色, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲, 最大: 1.5 mm², Tape
注文番号	1473350000
種別	LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118279788
数量	210 Stück
製品データ	IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
パッケージ	Tape

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12.7 mm	奥行き (インチ)	0.5 inch
高さ	14.45 mm	高さ (インチ)	0.569 inch
下位バージョンの高さ	14.45 mm	幅	21.7 mm
幅 (インチ)	0.854 inch	正味重量	5.742 g

温度

連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATEシグナル - シリーズLSF	導体接続方法	アクチュエータ付プッシュイン
PCB の取り付け	SMDはんだ接続	導体取り出し方向	135°
ピッチ (mm) (P)	3.5 mm	ピッチ (インチ) (P)	0.138 "
極数	6	ピンモデルシリーズ数量	1
顧客による実装済	いいえ	行数	1
共平面性:	100 µm	極当たりソルダーピン数	2
被覆剥き長さ	8 mm	L1 (mm)	17.5 mm
L1 (インチ)	0.69 "	DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP 20
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガータッチセーフ	保護度合い	IP20
体積抵抗	1.60 mΩ		

材料データ

絶縁材	LCP GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
はんだ接続の層構造	4...6 µm Sn matt	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C	温度範囲、設置、最小	-30 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C		

接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 28
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.2 mm ²
固定式、最大 H05 (07) V-U	1.5 mm ²
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.2 mm ²
フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	1.5 mm ²
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 0.25 mm ² 46228 pt 4、最小	
プラスチックカラー付フェルール DIN 0.75 mm ² 46228 pt 4、最大	
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小 0.25 mm ²	
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 1.5 mm ² pt 1、最大	

作成日 2024/07/04 8:23:08 CEST

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ


クランプ導体	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	フェルール端子	公称	0.25 mm ²
	導体接続断面	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.25/12 HBL
	フェルール端子	種別	配線の細線仕様
		公称	0.34 mm ²
	導体接続断面	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.34/12 TK
	フェルール端子	種別	配線の細線仕様
		公称	0.5 mm ²
	導体接続断面	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.5/14 OR
	フェルール端子	種別	配線の細線仕様
		公称	0.75 mm ²
	導体接続断面	被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.75/14T HBL

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません


IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	12 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	12 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	12 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	12 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	320 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	160 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	160 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	2.5 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	2.5 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3	2.5 kV	短時間耐電流抵抗	3 x 1sで80 A

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)		証明書番号 (CSA)	200039-1664286
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	10 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 28	導体断面積、AGW、最大	AWG 14
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)		証明書番号 (cURus)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	12 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 28	導体断面積、AGW、最大	AWG 14
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

作成日 2024/07/04 8:23:08 CEST

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

梱包

ESD レベルのパッケージ	静電気散逸	パッケージ	Tape
VPE 長	330 mm	VPE幅	330 mm
VPEの高さ	61 mm	テープの深さ (T2)	15.7 mm
テープ幅 (W)	56 mm	テープポケットの深さ (K0)	15.2 mm
テープポケットの高さ (A0)	11.3 mm	テープポケット幅 (B0)	44.06 mm
テープポケットの分離 (P1)	20 mm	テープホルルの分離 (E)	1.75 mm
テープポケットの分離 (F)	26.2 mm	テープリール径φ (A)	330 mm
表面抵抗	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$		

テストの種類

試験：マーキングの耐久性	テスト	原産地表示, 種類の識別, ピッチ, 承認マーキング UL, 耐久性
テスト：クランプ可能な断面	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.14 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.14 mm ²
		導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 22/19
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	0.2 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
	評価	合格した
	要件	0.3 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 撚線0.25 mm ²
		導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm ²
	評価	合格した
	要件	0.4 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した
引き抜き試験	標準	DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00
	要件	≥10 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
	評価	合格した
	要件	≥20 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 撚線0.25 mm ²
		導体の種類と導体断面 H05V-U0.5
	評価	合格した
	要件	≥40 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 H07V-U1.5
		導体の種類と導体断面 H07V-K1.5
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した

作成日 2024/07/04 8:23:08 CEST

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ECLASS 9.0	27-44-04-01	ECLASS 9.1	27-44-04-01
ECLASS 10.0	27-44-04-01	ECLASS 11.0	27-46-01-01
ECLASS 12.0	27-46-01-01	ECLASS 13.0	27-46-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

重要なメモ

IPC準拠 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

- 注意事項
- 要求に応じて追加のプッシュボタンの色
 - スライダの作動力は最大40 N
 - 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。
 - プラスチック製カラー付きワイヤエンドフェルールをDIN 46228/4に
 - プラスチック製カラーのないワイヤエンドフェルールをDIN 46228/1に
 - 図面上のP = ピッチ
 - 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。
 - PZ 6/5圧着工具を備えたワイヤエンドフェールの圧着形状「A」をお勧めします。
 - 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

作成日 2024/07/04 8:23:08 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of the Manufacturer
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel” Produkten
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL DRIVES EN PI OMNIMATE LSF SMD EN FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
ホワイトペーパーの表面取り付け技術	Download Whitepaper

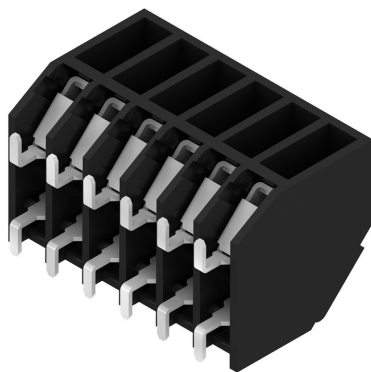
LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

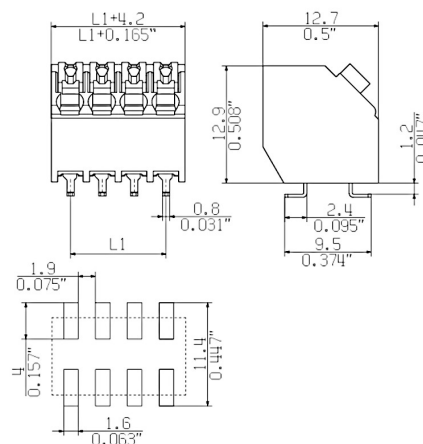
www.weidmueller.com

図面

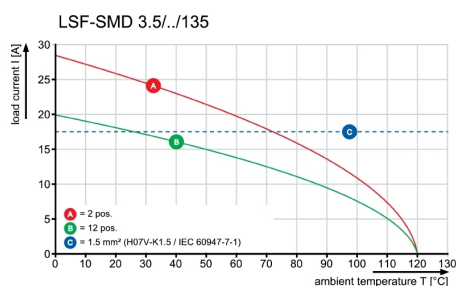
製品イメージ



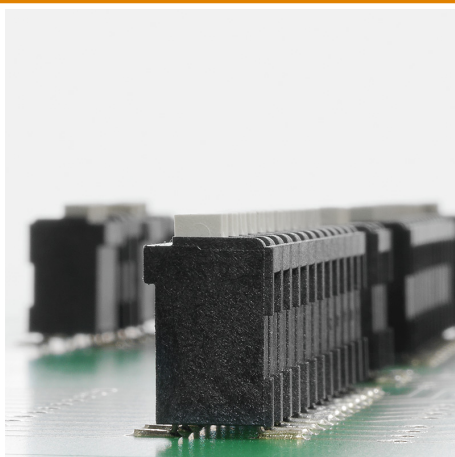
寸法図



グラフ

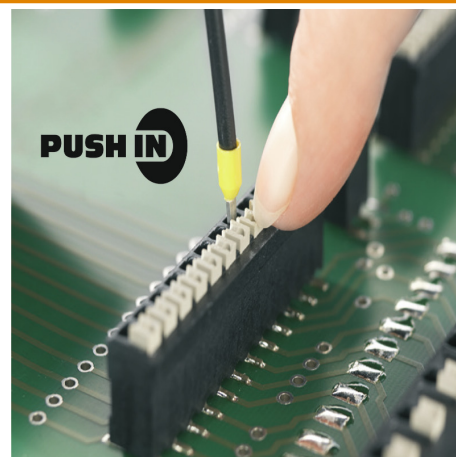


製品の利点



安定したはんだ付け接続

製品の利点



PUSH IN導体接続

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9008370000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056330	
数量	1 Stück	

LSF-SMD 3.50/06/135 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

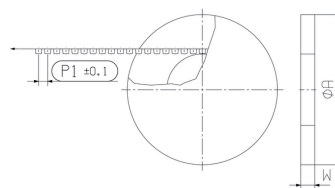
図面

製品の利点

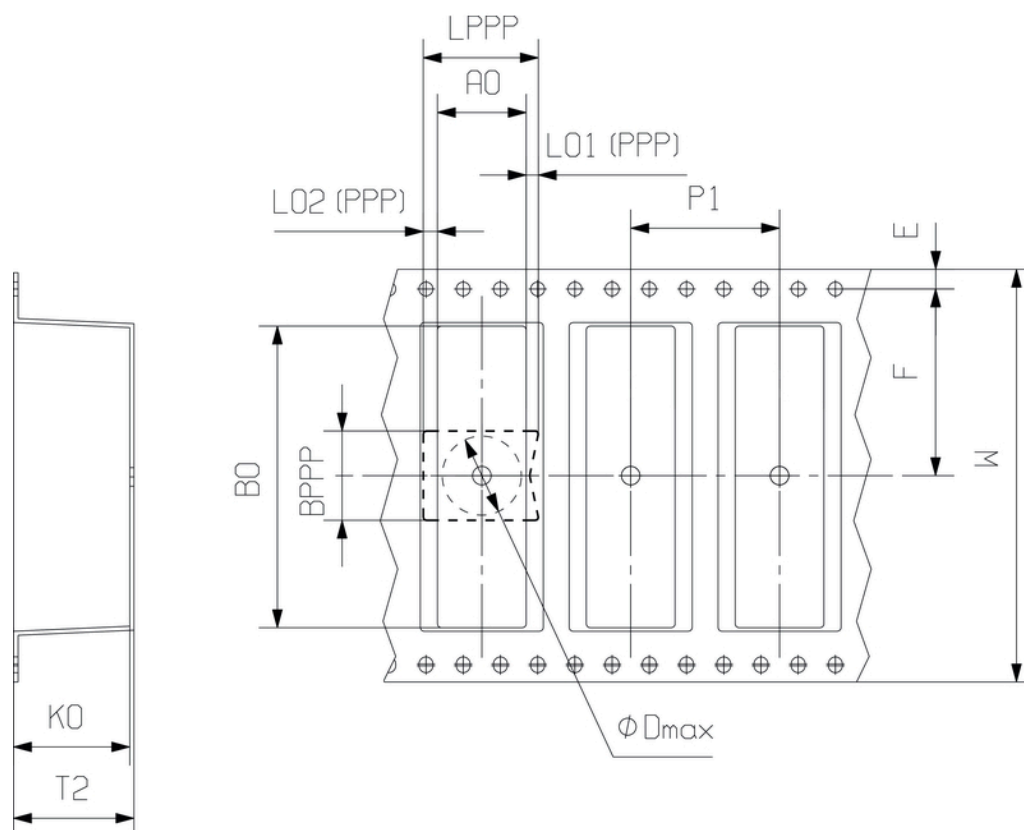


テープオンリールの梱包

寸法図



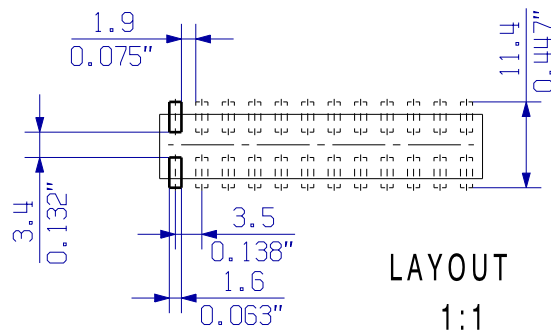
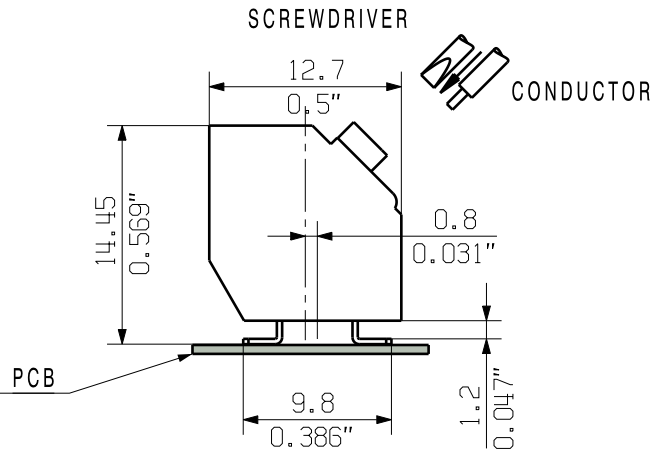
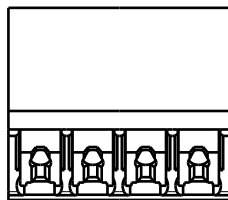
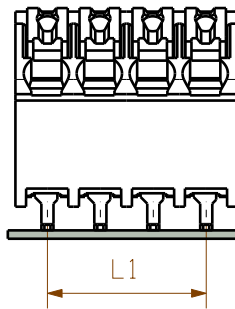
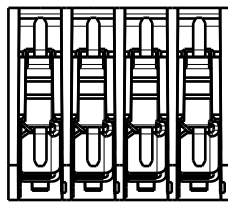
寸法図



DIRECTION OF UNREELING →

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING



LAYOUT
1:1

For the mounting on PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.

The necessary creepage and clearance paths must be observed in the relevant equipment standards in accordance with IEC 664 / VDE 0110.

The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3.

Weidmüller PCB components are rated in accordance with the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. If the components are used in accordance with the intended purpose, the components will meet all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress.

SHOWN: LSF-SMD 3.50/04/135...

12	38,5	1,516
11	35,0	1,378
10	31,5	1,240
9	28,0	1,102
8	24,5	0,965
7	21,0	0,827
6	17,5	0,689
5	14,0	0,551
4	10,5	0,413
3	7,0	0,276
2	3,5	0,138
n	L1 [mm]	L1 [Inch]

	DIN ISO 2768-m		86128/5 25.01.16 KRUG_M 01		CAT.NO.: . . .	
	MODIFICATION		DATE		NAME	
	DRAWN	03.06.2015	KRUG_M		LSF-SMD 3.50/./135 LEITERPLATTENKLEMM PCB TERMINAL	
	RESPONSIBLE		KRUG_M			
	CHECKED	02.02.2016	HELIS_MA			
SCALE: 2:1	APPROVED		LANG_T		PRODUCT FILE: LSF-SMD 3.50	
SUPERSEDES: .					7358	

Weidmüller

C 57457 **04**

DRAWING NO. SHEET 01 OF 04 SHEETS

ISSUE NO.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.